PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-145934

(43) Date of publication of application: 22.05.2002

(51)Int.CI.

C08F 20/18 C08F 20/28 C08F220/18 G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-340585

(71)Applicant: DAICEL CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

08.11.2000

(72)Inventor: ARAI TAKASHI

(54) RESIN FOR PHOTORESIST, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resin for photoresist, having excellent homogeneity and capable of providing minute pattern having high resolution.

SOLUTION: This high-molecular compound for the photoresist is produced by copolymerizing only monomers having functions of becoming alkali-soluble by leaving a protective group of an ester by an acid. The high-quality pattern is provided because the homopolymer included in the monomer having the functions of becoming alkali-soluble by leaving a protective group of an ester by an acid, as an impurity is removed by the development by an alkali solution at a step for producing a semiconductor. On the other hand, when a monomer having no functions of becoming alkali-soluble by leaving a protective group of an ester by an acid is used, the homopolymer included in the monomer causes a scum (an insoluble material) in an alkali developing solution to provide the insufficient resolution.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145934 (P2002-145934A)

(43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I デーマコート*(参考)
C08F 20/18		C 0 8 F 20/18 2 H 0 2 5
20/28		20/28 4 J 1 0 0
220/18		220/18
G03F 7/039	6 0 1	G 0 3 F 7/039 6 0 1
H01L 21/027	•	H01L 21/30 502R
		審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 10 頁
(21)出願番号	特顧2000-340585(P2000-340585)	(71) 出願人 000002901
		ダイセル化学工業株式会社
(22) 出願日	平成12年11月8日(2000.11.8)	大阪府堺市鉄砲町1番地
		(72)発明者 新井 隆
		兵庫県姫路市広畑区小坂164-26
		Fターム(参考) 2HO25 AAO2 AB16 ACO8 ADO3 BEOO
		BG00 CC03 FA03 FA12 FA17
		4J100 AL04R AL08P AL08Q AL08R
		BAO3Q BA11Q BCO3P BCO8P
		BOO8Q BOO9P BOO9Q BC12P
		BC12Q BC48P BC48Q BC53Q
	,	BC73R JA38

(54) 【発明の名称】 フォトレジスト用樹脂とその製造方法、及びフォトレジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 均質性に優れ、解像度の高い微細パターンを 得ることのできるフォトレジスト用樹脂を得る。

【解決手段】 本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、酸によりエステルの保護基が脱離しアルカリ可溶となる機能を持つモノマーだけで共重合し製造する。酸によりエステルの保護基が脱離しアルカリ可溶となる機能を持つモノマーに不純物として含まれるホモボリマーは半導体製造工程でのアルカリ液での現像により除かれるため高品位のバターンが得られる。一方、酸によりエステルの保護基が脱離しアルカリ可溶になる機能を持たないモノマーを使用した場合、そのモノマーに含まれるホモボリマーはアルカリ現像液でのスカム(不溶解物)発生により十分な解像度が得られない。

40

【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸によりエステルの保護基が脱離し、ア ルカリ可溶となる機能をもったモノマーだけを重合して 得られた高分子化合物。

【請求項2】 酸によりエステルの保護基が脱離し、ア ルカリ可溶となる機能をもったモノマーの種類が3種類*

(A;置換基を有していてもよい炭素数7から13の架 橋環状炭化水素。R1は水素原子又はメチル基を示し、R2 は炭素数1から4のアルキル基を示し、R3は水素原子又 は炭素数1から4のアルキル基を示し、R4は炭素数1か ら4のアルキル基を示し、R5は水素原子又は炭素数1か 20 ら4のアルキル基を示し、R6、R7は同一又は異なって水 素原子又はメチル基を示し、R8はtーブチル基又はピラ ニル基を示す。)で表される化合物より選ばれた請求項 1記載の高分子化合物。

【請求項4】 酸によりエステルの保護基が脱離し、ア ルカリ可溶となる機能をもったモノマーだけを重合して 得られた高分子化合物の製造方法。

【請求項5】 請求項1~3の何れかの項に記載の高分 子化合物を含むことを特徴とするフォトレジスト組成 物。

【請求項6】 請求項5記載のフォトレジスト組成物を 基材又は基板上に塗布してレジスト塗膜を形成し、露光 及び現像を経てバターンを形成する工程を含む半導体の 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工な どを行う際に用いるフォトレジスト用高分子化合物とそ の製造方法、前記フォトレジスト用高分子化合物を含む フォトレジスト組成物、並びに該フォトレジスト組成物 を用いた半導体の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路は集積化が進みし SIやVLSIが実用化されており、これに伴って最小 バターンはサブミクロン領域に及び、さらに微細化する 傾向にある。微細パターンの形成には、薄膜を形成した 被処理基板上をレジストで被覆し、選択露光を行った後 に現像してレジストパターンを作製し、これをマスクと してドライエッチングを行い、その後前記レジストを除 *以上で共重合することを特徴とする請求項1記載の高分 子化合物。

【請求項3】 酸によりエステルの保護基が脱離し、ア ルカリ可溶となる機能をもったモノマーが下記式(1) (2)(3)(4)

【化1】

術の使用が必須である。そしてこれに使用する露光光源 として、当初は紫外線が使用されていたが、パターンの 微細化に伴い波長の短い遠紫外線や電子線、X線等が使 用されるようになってきた。

【0003】そのため、特にエキシマレーザー(波長2 48nmのKrFレーザー、波長193nmのArFレ ーザー)を用いたリソグラフィ技術に対応して、高解像 性、高感度、優れた耐ドライエッチング性を有するレジ スト材料が要求されている。従来のレジストはフェノー ル樹脂又はノボラック樹脂をベースとするものが多い が、これらの材料は芳香族環を含んでおり、耐ドライエ ッチング性には優れているものの、KrFレーザー波長 に対しては透明性が低く、ArFレーザー波長に至って は不透明である。このため、従来の樹脂を用いては微細 30 パターンを得ることはできなかった。

【0004】一方、最近、酸触媒と化学増幅効果を利用 した高感度レジストについて、各種の提案がなされてい る。より具体的には、(1)活性光線(紫外線、遠紫外 線、真空紫外光、電子線、X線、各種レーザー光など) の照射により酸を発生する光酸発生剤と、(2)酸に対 して不安定な反復的に存在する枝分かれした基を有する 重合体との組み合わせからなるレジスト組成物が注目さ れている。このレジスト組成物から形成されたレジスト 膜に活性光線を照射すると、被照射部分において、光酸 発生剤から酸が生成し、この酸の作用を受けて、重合体 中の酸に対して不安定な反復的に存在する基が分解され て極性基が生成する。これによって、レジスト膜の露光 領域及び未露光領域の溶解度特性に大きな変化が生じ る。すなわち、露光領域の重合体は極性基が形成されて アルカリ可溶となるため、アルカリ水溶液や極性溶媒で 現像することにより露光領域が選択的に除去される。一 方、未露光領域の重合体は無極性であるため、無極性溶 媒で現像すると未露光領域が選択的に除去される。した がって、現像液を選択することにより、ポジ型、ネガ型 去することにより所望のパターンを得るリソグラフィ技 50 の何れにも使用可能となる。多くの場合、現像液として

アルカリ水溶液を用いることにより露光領域を除去して いる。なお、重合体中の酸に対して不安定な反復的に存 在する枝分かれした基は保護されたアルカリ水溶性基で あって、酸により重合体から脱離可能な基であることか ら、保護基と称されている。光酸発生剤から生成した酸 の作用によりこの保護基の脱離反応(開裂反応)が生じ るが、この反応に伴って、新たに酸が再生されるため、 このレジスト組成物は化学増幅型となり、高感度であ る。

【0005】最近、エキシマ光に対して透明なレジスト として、メタクリル酸 t - ブチル重合体が提案されてい るが、このレジストは耐ドライエッチング性に欠ける。 この耐ドライエッチング性を備え、さらにKェFレーザ ー、ArFレーザーの波長に対して透明性を持つものと して、脂環式基を有する重合体を用いた化学増幅型レジ ストが報告されている(特開平4-39665号公報、 特開平5-257284号公報、特開平5-26521 2号公報、特開平7-234511号公報、特開平9-73173号公報など)。前記脂環式基に対応する脂環 式炭化水素環として、ノルボルネン、パーヒドロアント ラセン、シクロヘキサン、トリシクロデカン、アダマン タンなどが望ましい。

【0006】しかしながら、上記の脂環式基を有する重 合体を用いた化学増幅型レジストにおいては、耐ドライ エッチング性を付与する脂環式基が、その組成比の増加 につれて重合体の疎水性を高めるとともに剛直性をも増 大させる。このため、フェノール樹脂又はノボラック樹 脂をベースにしたレジスト並のドライエッチング耐性が 得られる組成比、例えば脂環式基を有する構造単位が5 0モル%以上の領域では、高い疎水性に加え、その硬さ のために触媒であるプロトン酸の拡散が妨げられ、増幅 率が低下し、結果として生成するカルボン酸量が減少 し、現像液であるアルカリ水溶液に対する溶解性が低下 するという問題があった。

【0007】また、これらのレジストは密着性に乏し く、脂環式基の導入によりレジスト膜が硬くなるため、 レジスト膜にかかる歪みが大きくなって剥がれやすくな る。このため安定したパターン特性を得ることができな いという問題もあった。

【0008】そこで、エキシマ光等を用いる化学増幅型 40 レジストとして、酸の存在下、レーザー光によって反 応、脱離する置換基を有する脱離性モノマーと、基板と の密着性を高める置換基を持つ密着性モノマーとの共重 合体を用いることが提案されている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、エキシマレー ザー光を用いた次世代の半導体におけるライン・アンド ·スペース(L&S)の要求は0.1ミクロンのオーダ ーとなり、微量な異物の混入もゆるされない。特に重合 に用いるモノマー中に含まれる重合物なども異物の対象 50 ることを特徴とすることにより、スカム(不溶物)の少

となるが、重合物をまったく含まないモノマーを得るこ とは煩雑であり、経済的にも負担がおおくなる。

【0010】このように、エキシマレーザー光を用いる 化学増幅型レジストとしては、酸によりエステルの保護 基が脱離しアルカリ可溶となるモノマー(以降、脱離性 モノマーと呼ぶこともある)と基盤等への密着性を有す るモノマー(以降、密着性モノマーと呼ぶこともある) との共重合体からなるが、これまで多く報告されている これらArF・KrFレーザー用感光体に使用される共 重合体は、脱離型モノマーと密着性モノマーとを主体と する共重合体であった(特開平4-39665、特開平 5-257284、特開平5-265212、特開平7 -234511、特開平9-73173、特開平11-49806)。この場合、如何にモノマーの合成方法 に注力しても得られたモノマーには、そのモノマーの重 合物(以降、ホモポリマーと呼ぶ)を含んでいる可能性 が非常に高くなる。これらのホモポリマーはモノマーの 精製段階でメタノールなどのポリマー貧溶媒を使用すれ ば取り除けるが、ポリマー除去後に温浴下でメタノール を留去する操作によって再度モノマーが重合し、ホモポ 20 リマーが生成する可能性が高く、結果として少量のホモ ポリマーが残る場合が多い。また、保存中に加えられた 熱・光等によってモノマーが微量重合しホモポリマーを 含むモノマーへ経時的に変化する場合も多い。さらにモ ノマーを重合し高分子化合物を製造する段階では、複数 のモノマーの反応性比(重合する反応速度の比率)の関 係から密着性モノマーの重合速度が速いときは密着性モ ノマーのみからなるホモポリマーが生成してしまう場合 も非常に多い。このため酸により保護基が脱離してアル カリ可溶な高分子でない密着性モノマーを使用した場 合、またはその他の目的で使用されたモノマーが酸によ り保護基が脱離してアルカリ可溶な高分子でないモノマ ーである時は、モノマー中のホモボリマー或いは重合過 程で発生するホモポリマーいずれの場合にも、露光し、 更に加熱処理(ベーク)の後においてアルカリ現像液に 溶解しない形であり、結果としてスカム(露光およびべ ーキングの後、アルカリ現像液で洗浄するも不溶物とし て残るもの)として系内に残存し不良品発生の原因とな ってしまう。

[0011]

【課題を解決するための手段】従って、本発明の目的 は、均質性に優れ、解像度の高い微細パターンを得ると とのできるフォトレジスト用樹脂とその製造方法を提供 することにある。本発明の他の目的は、髙解像度の微細 パターンを得ることができるフォトレジスト組成物、及 び半導体の製造方法を提供することにある。

【0012】本発明者らは、上記目的を達成するため鋭 意検討した結果、共重合に使用するモノマーはすべて酸 により保護基が脱離しアルカリ可溶となるモノマーであ

ない半導体生産において非常に効果的なレジスト材料を 提供できることを見出し、本発明を完成するに至った。 【0013】すなはち、本発明は、酸によりエステルの 保護基が脱離し、アルカリ可溶となる機能をもったモノ マーだけを重合して得られた髙分子化合物を提供する。 本発明は、また、酸によりエステルの保護基が脱離し、 アルカリ可溶となる機能をもったモノマーだけで、しか*

【0015】(A;置換基を有していてもよい炭素数7 から13の架橋環状炭化水素。R1は水素原子又はメチル 基を示し、R2は炭素数1から4のアルキル基を示し、R3 は水素原子又は炭素数1から4のアルキル基を示し、R4 20 は炭素数1から4のアルキル基を示し、R5は水素原子又 は炭素数 1 から 4 のアルキル基を示し、R6、R7は同一又 は異なって水素原子又はメチル基を示し、R8はt―ブチ ル基又はピラニル基を示す。)で表される化合物より選 ばれた高分子化合物を提供する。

【0016】本発明は、また、酸によりエステルの保護 基が脱離し、アルカリ可溶となる機能をもったモノマー だけを重合して得られた高分子化合物を製造する方法を 提供する。

り得られるフォトレジスト用樹脂を提供する。本発明 は、さらにまた、前記の各製造方法により得られるフォ トレジスト用樹脂を含むフォトレジスト組成物を提供す

【0018】本発明は、また、上記のフォトレジスト組 成物を基材又は基板上に塗布してレジスト塗膜を形成 し、露光及び現像を経てパターンを形成する工程を含む 半導体の製造方法を提供する。

【0019】なお、本明細書では、「アクリル」と「メ タクリル」とを「(メタ)アクリル」、「アクリロイ ル」と「メタクリロイル」とを「(メタ)アクリロイ ル」と総称する場合がある。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明で使用される酸により脱離 しアルカリ可溶となるモノマーとして、(メタ)アクリル 酸エステル類がある。

【0021】前記式(1)に対応するものとして、2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチルアダマンタ ン、2-(メタ)アクリロイルオキシ-2-エチルアダ * もその種類が3種類以上で共重合することを特徴とする の高分子化合物を提供する。本発明は、また、酸により エステルの保護基が脱離し、アルカリ可溶となる機能を もったモノマーが下記式(1)(2)(3)(4) [0014] [化2]

プロビルアダマンタン、1-ヒドロキシ-2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチルアダマンタン、5-ヒ ドロキシー2-(メタ)アクリロイルオキシー2-メチ ルアダマンタン、1,3-ジヒドロキシ-2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチルアダマンタン、1,5 -ジヒドロキシ-2-(メタ)アクリロイルオキシ-2 - メチルアダマンタン、1,3-ジヒドロキシー6-(メタ) アクリロイルオキシー6-メチルアダマンタン などがある。また、架橋環状炭化水素部分が上記で示し たアダマンタンの代わりにノルボルナン、パーヒドロア ントラセン、トリシクロデカンなどがある。

【0022】また、前記式(2)に対応するものとし て、1-(1-メチル-1-(メタ)アクリロイルオキ 【0017】本発明は、さらに、前記の各製造方法によ 30 シエチル)アダマンタン、1-(1-メチル-1-(メ タ) アクリロイルオキシエチル) -3-ヒドロキシアダ マンタン、1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー1 -メチルエチル)アダマンタン、1-(1-メチルー1 - (メタ) アクリロイルオキシエチル) - 3, 5 - ジヒ ドロキシアダマンタン、1-(1-エチル-1-(メ タ) アクリロイルオキシブロピル) アダマンタン、1-(1-エチル-1-(メタ)アクリロイルオキシプロピ ル) -3-ヒドロキシアダマンタン、1-(1-(メ タ) アクリロイルオキシー1-メチルプロピル) アダマ 40 ンタン、1-(1-(メタ)アクリロイルオキシー1-メチルプロピル) -3-ヒドロキシアダマンタン、1-(1-(メタ) アクリロイルオキシー1, 2-ジメチル プロピル)アダマンタン、1-(1-(メタ)アクリロ イルオキシー1,2-ジメチルプロピル)-3-ヒドロ キシアダマンタン、1-(1-エチル-1-(メタ)ア クリロイルオキシプロピル) -3,5-ジヒドロキシア ダマンタン、1,3-ジヒドロキシ-5-(1-(メ タ) アクリロイルオキシー1-メチルブロピル) アダマ ンタン、1、3-ジヒドロキシ-5-(1-(メタ)ア マンタン、2-(メタ)アクリロイルオキシ-2-イソ 50 クリロイルオキシ-1,2-ジメチルプロピル)アダマ

ンタンなどがある。また、架橋環状炭化水素部分が上記 で示したアダマンタンの代わりにノルボルナン、パーヒ ドロアントラセン、トリシクロデカンなどがある。

【0023】また、前記式(3)に対応するものとして 3-(メタ)アクリロイルオキシ-ケーブチロラクト ン、3-(メタ)アクリロイルオキシ-3-メチル-~ ーブチロラクトン、3 ー (メタ) アクリロイルオキシー 4-メチル-アーブチロラクトン、3-(メタ)アクリ ロイルオキシー3、4ージメチルーケーブチロラクト ン、3 - (y) アクリロイルオキシー4、4 - y 10 ルーャーブチロラクトン、3ー(メタ)アクリロイルオ キシ-3, 4, 4-トリメチル-γ-ブチロラクトンな どがある。

【0024】また更に、前記式(4)に対応するものと して t - ブチル(メタ)アクリレート、ピラニル(メタ)ア クリレートなどがある。

【0025】これまでに示したモノマーを複数選択し、 共重合する場合、架橋脂環式炭化水素を分子中に含有す るモノマーは、モル比で30%以上、好ましくは40% 以上、特に好ましくは50%以上の比率で組み合わせる ことが必要である。架橋乾式炭化水素を分子中に含有す るモノマーとは、前記式(1)及び(2)に記載したも のである。

【0026】選択されたモノマーから本発明の高分子を 製造する方法としては、これらのモノマー成分を有機溶 媒中に溶解させ、重合開始剤の存在下、重合温度40℃ ~150℃、好ましくは60℃~100℃で、重合時間 1~24時間、好ましくは3~15時間反応させること によって得ることができる。有機溶媒としては、例え ば、テトラハイドロフラン、ジオキサンなどのエーテル 類;ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素類、アセ トン、メチルエチルケトンなどのケトン類、メタノー ル、エタノールなどのアルコール類、四塩化炭素、クロ ロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化メチル類、ジ メチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドなどを挙げ ることができる。これらの有機溶媒は、それぞれ単独 で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することがで きる。これらの中でもエーテル類が特に好ましい。

【0027】重合開始剤としては、シクロヘキサノンパ ーオキサイド、3、3、5ートリメチルシクロヘキサノ ンパーオキサイド、メチルシクロヘキサノンパーオキサ イド等のケトンパーオキサイド類、1、1ービス(t-ブチルパーオキシ) シクロヘキサン、nーブチルー4、 4ービス(tーブチルパーオキシ)バレレート等のパー オキシケタール類、クメンハイドロバーオキサイド、ジ イソプロピルベンゼンパーオキサイド、2、5ージメチ ルヘキサンー2、5ージハイドロパーオキサイド類、 t ーブチルクミルパーオキサイド、α、αービス(tーブ チルパーオキシーmーイソプロピル)ベンゼン、2、5 ージメチルー2、5ージ(tーブチルパーオキシーmー

イソプロピル)ベンゼン、2、5ージメチルー2、5ー ジ(tーブチルパーオキシ)へキシンー3等のジアルキ ルパーオキサイド類、デカノイルパーオキサイド、ラウ ロイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、 2、4ージクロロベンゾイルパーオキサイド等のジアシ ルパーオキサイド類、ビス(tーブチルシクロヘキシ ル) パーオキシジカーボネート等ノパーオキシカーボネ ート類、tーブチルパーオキシベンゾエート、2、5 ー ジメチルー2、5ージ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサ ン等のパーオキシエステル類等の有機過酸化物と2、2 **´ーアゾビス(イソブチロニトリル)、2、2´ーアゾ** ビス(2、4ージメチルバレロニトリル)、2、2´ー アゾビス(4ーメトキシー2、4ージメチルバレロニト リル)、ジメチルー2、2 ´ーアゾピスイソブチレー ト、4、4 ´ーアゾビス(4ーシアノペンタノイック 酸)、アゾビスシクロヘキサンカルボニトリル、2、2 **´ーアゾビスプロピオンニトリル、2、2´ーアゾビス** (2ーメチルブチロニトリル)、1、1 ~ーアゾビス (シクロヘキサンー1ーカーボニトリル) 等のアゾ化合 物があり、これらを単独で、または2種類以上の混合物 として用いることができる。これらの中でも、アゾ化合 物が好ましい。

【0028】重合反応では、モノマー及び重合開始剤を 含有する溶液を攪拌しながら反応を開始し、かつ重合反 応中、反応溶液の攪拌を継続することが必要である。攪 拌は、攪拌翼や攪拌子を回転させる方法などが挙げられ る。攪拌翼や攪拌子を回転させる方法を採用する場合に は、反応溶液を一定の回転数で攪拌することが好まし 41

【0029】本発明の製造方法によれば、重量平均分子 量(Mw)が2000~20000、好ましくは300 0~15000、特に好ましくは5000~12000 で、分散度(Mw/Mn)が4.0以下、好ましくは3.0以 下の(メタ)アクリル酸エステル共重合体を得ることが できる。重量平均分子量 (Mw) 及び分散度 (Mw/M n)が大きすぎると、レジスト膜が白濁したり、あるい は感度や解像度などのレジスト特性が低下する傾向を示 す。なお、重量平均分子量(Mw)及び数平均分子量 (Mn)は、屈折率(RI)を用いたテトラヒドロフラ

ン溶媒でのゲルパーミエイションクロマトグラフィー (GPC) により測定されたポリスチレン換算の重量平 均分子量及び数平均分子量である。本発明によれば、化 学増幅型レジストの基材高分子として、レジスト用溶剤 に対する溶解性が良好で、しかも露光後にスカム(不溶 物) の発生しない (メタ) アクリル酸エステル共重合体 を安定的に製造することができる。

【0030】本発明のフォトレジスト組成物は、前記方 法により得られる共重合体からなるフォトレジスト用樹 脂(フォトレジスト用高分子化合物)のほか、光酸発生 50 剤、溶媒、及び必要に応じて各種添加剤を含んでいる。

10

フォトレジスト組成物は酸のクエンチャーとしてアミン 類を含んでいてもよい。

【0031】前記光酸発生剤としては、露光光を照射す ることにより酸を発生するものであれば特に限定され ず、慣用乃至公知の光酸発生剤を使用できる。例えば、 光酸発生剤として、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩 (例えば、ジフェニルヨードヘキサフルオロホスフェー トなど)、スルホニウム塩(例えば、トリフェニルスル ホニウムヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニル スルホニウムヘキサフルオロホスフェート、トリフェニ 10 ルスルホニウムメタンスルホネートなど)、スルホン酸 エステル [例えば、 1 - フェニル - 1 - (4 - メチルフ ェニル) スルホニルオキシー1-ベンゾイルメタン、 1.2.3-トリスルホニルオキシメチルベンゼン、 1. 3-ジニトロ-2-(4-フェニルスルホニルオキ シメチル) ベンゼン、1-フェニル-1-(4-メチル フェニルスルホニルオキシメチル)-1-ヒドロキシー 1-ベンゾイルメタンなど]、オキサチアゾール誘導 体、 s - トリアジン誘導体、ジスルホン誘導体(ジフェ ニルジスルホンなど)、イミド化合物、オキシムスルホ 20 ネート、ジアゾナフトキノン、ベンゾイントシレートな どが挙げられる。光酸発生剤は単独で又は2種以上組み 合わせて使用できる。

【0032】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度や前記共重合体における各モノマー単位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記共重合体100重量部に対して0.1~30重量部、好ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重量部程度の範囲から選択できる。

【0033】前記溶媒としては、例えば、炭化水素類、 ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、エステル類、ア ミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビ トール類、グリコールエーテルエステル類等の有機溶 媒、及びこれらの混合溶媒などが挙げられる。

【0034】上記フォトレジスト組成物は半導体の製造用に好適に使用できる。すなわち、例えば、前記フォトレジスト組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介して、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さらに露光後ベークを行い)潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパ 40ターンを高い精度で形成できる。

【0035】基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト組成物の塗布は、例えば、スピンコータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば $0.1\sim20\mu$ m、好ましくは $0.2\sim2\mu$ m程度である。

【0036】露光には、種々の波長の光線、例えば、紫 2g (100mmo1)、3-(3g)アクリロイ外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通 50 オキシー $\gamma-$ ブチロラクトン13.6g(80mmo

常、g線、i線、エキシマレーザー (例えば、XeC 1、KrF、KrC1、ArF、ArC1など) などが使用される。露光エネルギーは、例えば $1\sim1000$ m J/c m^2 、好ましくは $10\sim500$ m J/c m^2 程度である。

【0037】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、その後加熱処理(ベークと呼ぶ)によりこの酸により前記共重合体のうち酸脱離性基が速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等が生成する。加熱温度は、通常、30~200℃、好ましくは50~170℃である。本発明のフォトレジスト組成物に対する現像液としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、アンモニア水や有機アミン化合物、例えばメチルアミン、エチルアミン、イソプロビルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、エタノールアミン、ビベリジン等が単独又は組み合わせて使用できる。また、現像液には各種の有機溶媒を添加するともできる。なを、アルカリで現像した後は、通常純水等の水で洗浄する。

0 [0038]

【発明の効果】本発明による高分子化合物をフォトレジスト組成物に応用すると、酸により脱離しアルカリ可溶となるモノマーだけで共重合しているため、光照射後のアルカリ現像において鮮明なるライン・アンド・スペースが得られた。また、微量のホモボリマーを含んでいていても、レジスト材料として使用可能であり、モノマーの製造から貯蔵、またボリマーの製造において、過度の精製手段を省くことも可能となり、経済的にも優位性のある材料を提供することになった。

30 [0039]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定 されるものではない。

【0040】実施例1

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合 成

[0041]

[化3]

[0042]三角フラスコに1-(1-(xy))アクリロイルオキシ-1-xチルエチル)アダマンタン26. 2g(100mmo1)、3-(xy)アクリロイルオキシーx-7チロラクトン13. 6g(80mmo)

12

11

1)、t-ブチル (メタ) アクリレート1. 4g(10 mmol)、開始剤2, 2^{-} -アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル) (和光純業製=商品名V65) 4. 7gを入れ、THF190g に溶解懸濁させ重合溶液とした。

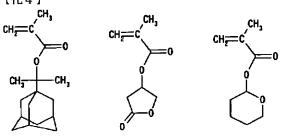
【0043】との重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10m1フラスコに張り込み、温度を60 °Cに保ち、10時間攪拌した後、反応液を500m1のへキサンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製の高分子を得た。それをTHF190gに再度溶解し、500m1の 10へキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、更に乾燥することにより乾燥することにより目的とする樹脂 32gを得た。得られたボリマーをGPC分析したところ、Mwが8000、分散度(Mw/Mn)が2.4であった。得られたボリマーのレジスト特性を評価した。

【0044】実施例2

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合 成

[0045]

[1t4]



[0046] 三角フラスコに1-(1-(yg)) アクリロイルオキシ-1-y チルエチル)アダマンタン26.2g (100mmo1)、3-(yg) アクリロイルオキシ $-\gamma$ -ブチロラクトン13.6g(80mmo1)、テトタハイドロビラニル(yg) アクリレート1.7g(10mmo1)、開始剤 $2,2^{\gamma}$ -アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(和光純薬製=商品名ye65)4.7gを入れ、ye7 のye7 で溶を別数では重合溶液とした。

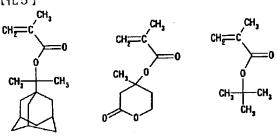
【0047】との重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10mlフラスコに張り込み、温度を60℃に保ち、10時間攪拌した後、反応液を500mlのヘキサンに落とし、生じた沈殿を3別し、粗製のボリマーを得た。それをTHF190gに再度溶解し、500mlのヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿を3過し、更に乾燥することにより目的とするポリマー30gを得た。得られたポリマーをGPC分析したところ、Mwが8700、分散度(Mw/Mn)が2.8であった。得られたポリマーのレジスト特性を評価した。

【0048】実施例3

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合成

【0049】 【化5】

(7)



【0050】三角フラスコに1-(1-(xy))アクリロイルオキシ-1-xチルエチル)アダマンタン26. 2g-(100mmol)、3-(xy)アクリロイルオキシーメバロニックラクトン15. 8g-(80mmol)、t-ブチル(xy)アクリレート1. 4g-(10mmol)、開始剤2, 2 - アゾビス(2, 4 - ジメチルバレロニトリル)(和光純薬製=商品名V65)4. 7gを入れ、THF190g に溶解懸濁させ重合溶液とした。

20 【0051】 この重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10mlフラスコに張り込み、温度を60℃に保ち、10時間攪拌した後、反応液を500mlのヘキサンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のボリマーを得た。それをTHF190gに再度溶解し、500mlのヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、更に乾燥することにより目的とするボリマー35gを得た。得られたボリマーをGPC分析したところ、Mwが9000、分散度(Mw/Mn)が3.0であった。得られたボリマーのレジスト特性を評価した。

(0052]実施例4

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合 成

[0053]

【化6】

40

【0054】三角フラスコに1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルエチル) アダマンタン26.
2g (100mmol)、(メタ) アクリロイルオキシーメバロニックラクトン15.8g(80mmol)、テトラハイドロピラニル(メタ) アクリレート1.7g(10mmol)、開始剤2,2´ーアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(和光純薬製=商50品名V65)4.7gを入れ、THF190gに溶解懸

(8)

濁させ重合溶液とした。

【0055】との重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10mlフラスコに張り込み、温度を60℃に保ち、10時間攪拌した後、反応液を500mlのヘキサンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のポリマーを得た。それをTHF190gに再度溶解し、500mlのヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、更に乾燥するととにより目的とするポリマー32gを得た。得られたポリマーをGPC分析したところ、Mwが8700、分散度(Mw/Mn)が2.6であった。得られた 10ポリマーのレジスト特性を評価した。

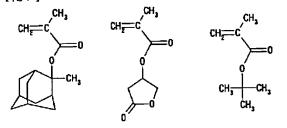
13

【0056】実施例5

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合 成

[0057]

【化7】



【0058】三角フラスコに2-(yy) アクリロイルオキシ-2-アダマンタン23. 4g(100mmo1)、3-(yy) アクリロイルオキシー $\gamma-$ ブチロラクトン13. 6g(80mmo1)、t-ブチル(メタ)アクリレート1. 4g(10mmo1)、開始剤2, $2^{-}-$ アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル)(和光純薬製=商品名V65)4. 7gを入れ、THF190gに溶解懸濁させ重合溶液とした。

【0059】この重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10mlフラスコに張り込み、温度を60℃に保ち、10時間攪拌した後、反応液を500mlのヘキサンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のボリマーを得た。それをTHF190gに再度溶解し、500mlのヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、乾燥することにより目的とする樹脂35gを得た。得られたボリマーをGPC分析したところ、Mwが8700、分散度(Mw/Mn)が2.6であった。得られたボリマーのレジスト特性を評価した。

【0060】実施例6

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合成

[0061] [化8] CH₂-C, CH₃

【0062】三角フラスコに2 - (メタ)アクリロイルオキシ-2 -アダマンタン23.4g (100mmo 1)、3 - (メタ)アクリロイルオキシ- γ - ブチロラクトン13.6g (80mmo1)、テトラハイドロビラニル(メタ)アクリレート1.7g (10mmo 1)、開始剤2、2 $^{'}$ - アゾビス(2、4 - ジメチルバレロニトリル)(和光純薬製=商品名V65)4.7g を入れ、THF190g に溶解懸濁させ重合溶液とした。

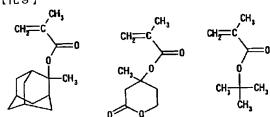
【0063】この重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10m1フラスコに張り込み、温度を60℃に20 保ち、10時間攪拌した後、反応液を500m1のヘキサンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のボリマーを得た。それをTHF190gに再度溶解し、500m1のヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、乾燥することにより目的とする樹脂32gを得た。得られたボリマーをGPC分析したところ、Mwが8000、分散度(Mw/Mn)が2.5であった。得られたボリマーのレジスト特性を評価した。

【0064】実施例7

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合 30 成

[0065]

【化9】



【0066】三角フラスコに2-(メタ)アクリロイルオキシ-2-アダマンタン23.4g(100mmo1)、(メタ)アクリロイルオキシーメバロニックラクトン15・8g(80mmo1)、tーブチル(メタ)アクリレート1.4g(10mmo1)、開始剤2,2~-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(和光純薬製=商品名V65)4.7gを入れ、THF190gに溶解懸濁させ重合溶液とした。

【0067】 この重合溶液を、還流管および3方コックを備えた10mlフラスコに張り込み、温度を60℃に50 保ち、10時間攪拌した後、反応液を500mlのヘキ

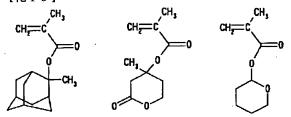
サンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のポリマーを 得た。それをTHF190gに再度溶解し、500ml のヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、乾燥する ことにより目的とする樹脂30gを得た。得られたポリ マーをGPC分析したところ、Mwが8500、分散度 (Mw/Mn)が2.4であった。得られたポリマーの レジスト特性を評価した。

[0068]実施例8

下記モノマーを使用した共重合による高分子化合物の合 成

[0069]

【化10】



オキシ-2-アダマンタン23. 4g(100mmo 1)、(メタ)アクリロイルオキシーメバロニックラク トン15.8g(80mmol)、t-ブチル(メタ) アクリレート1. 4g(10mmol)、開始剤2, 2 ´ーアゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(和 光純薬製=商品名V65) 4. 7gを入れ、THF19 0gに溶解懸濁させ重合溶液とした。

【0071】この重合溶液を、還流管および3方コック を備えた10m1フラスコに張り込み、温度を60℃に 保ち、10時間攪拌した後、反応液を500mlのヘキ サンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のポリマーを 得た。それをTHF190gに再度溶解し、500m1 のヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、乾燥する ことにより目的とする樹脂32gを得た。得られたポリ マーをGPC分析したところ、Mwが8000、分散度 (Mw/Mn)が2. 4であった。得られたポリマーの レジスト特性を評価した。

【0072】比較例1

酸により脱離してアルカリ可溶になるモノマーである1 - (1-(メタ)アクリロイルオキシ-1-メチルエチ 40 ル) アダマンタンの代わりに下記モノマーを使用した以 外は実施例1と同様にして共重合を行った。

[0073]

【化11】

【0074】三角フラスコに1-(メタ)アクリロイル オキシアダマンタン22.0g (100mmol)、 10 3-(メタ)アクリロイルオキシ-ィーブチロラクトン 13.6g(80mmol)、t-ブチル(メタ)アク リレート1. 4g(10mmo1)、開始剤2, 2´-アゾビス(2、4-ジメチルバレロニトリル)(和光純 薬製=商品名V65)4.7gを入れ、THF190g に溶解懸濁させ重合溶液とした。

【0075】この重合溶液を、還流管および3方コック を備えた10mlフラスコに張り込み、温度を60℃に 保ち、10時間攪拌した後、反応液を500m1のヘキ サンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のポリマーを 【0070】三角フラスコに2-(メタ)アクリロイル 20 得た。それをTHF190gに再度溶解し、500ml のヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、更に乾燥 することにより目的とするポリマー32gを得た。得ら れたポリマーをGPC分析したところ、Mwが800 分散度(Mw/Mn)が3.5であった。得られた ポリマーのレジスト特性を評価した。

【0076】比較例2

酸により脱離してアルカリ可溶になるモノマーである3 ~ (メタ) アクリロイルオキシ- ~- ブチロラクトンの 代わりに下記モノマーを使用した以外は実施例1と同様 にして共重合を行った。

[0077]

【化12】

【0078】三角フラスコに1-(1-(メタ)アクリ ロイルオキシー1-メチルエチル)アダマンタン26. 2g (100mmol)、2-(メタ)アクリロイル オキシー4, 4-ジメチルー $\gamma-$ ブチロラクトン15. 9g(80mmol), $t-\overline{7}$ $\overline{7}$ $\overline{7}$ ト1.4g(10mmol)、開始剤2,2´-アゾビ ス(2,4-ジメチルバレロニトリル)(和光純葉製= 商品名V65) 4. 7gを入れ、THF190gに溶解 懸濁させ重合溶液とした。

50 【0079】 この重合溶液を、還流管および3方コック

を備えた10m1フラスコに張り込み、温度を60℃に保ち、10時間攪拌した後、反応液を500m1のヘキサンに落とし、生じた沈殿をろ別し、粗製のボリマーを得た。それをTHF190gに再度溶解し、500m1のヘキサンに注ぎ込み、生じた沈殿をろ過し、更に乾燥することにより目的とするボリマー3gを得た。得られたボリマーをGPC分析したところ、Mwが8000、分散度(Mw/Mn)が3.3であった。得られたボリマーのレジスト特性を評価した。

17

【0080】評価試験

実施例及び比較例で得られた各樹脂につき、以下の評価 試験を行った。前記樹脂100重量部と、トリフェニル スルホニウムヘキサフルオロアンチモン15重量部と、 18

乳酸エチル(溶媒)とを混合し、フォトレジスト組成物を調製した。この組成物をシリコンウエハーにスピンコーティングにより塗布し、厚み1.0μmの感光層を形成した。ホットプレート上で60℃で100秒間プリベークした後、KrFエキシマステッパを用い、照射量100mJ/cm²で露光した後、温度100℃で60秒間ベークした。次いで、アルカリ水溶液(東京応化(株)製、NMD-3)を用いて60秒間現像し、純水でリンスした。その結果、実施例1~8で得られた樹脂でリンスした。その結果、実施例1~8で得られた樹脂を用いた場合には、所望の微細パターンが得られたが、比較例1及び2で得られた樹脂を用いた場合には解像度が不十分であった。